

2027年2月期(第42期) 第2四半期 決算説明資料

2026年10月8日

ローゼ株式会社

証券コード：6323

<https://www.rorze.com/ir>

◆ 将来見通しに関する記述について

本資料に記載されている業績予想、将来予測などは、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、その情報の正確性、完全性を保証したり、約束したりするものではありません。また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なく変更されることがあります。

◆ 本資料における表示方法について

数 値： 単位未満を切り捨て

比 率： 1円単位の金額で計算後、単位未満四捨五入

会計年度： 年度開始日の暦年表記（「2027年2月期」を「FY2026」または「FY'26」と表記）

会計期間： 連結・当社、国内および海外子会社の会計期間は次のとおり

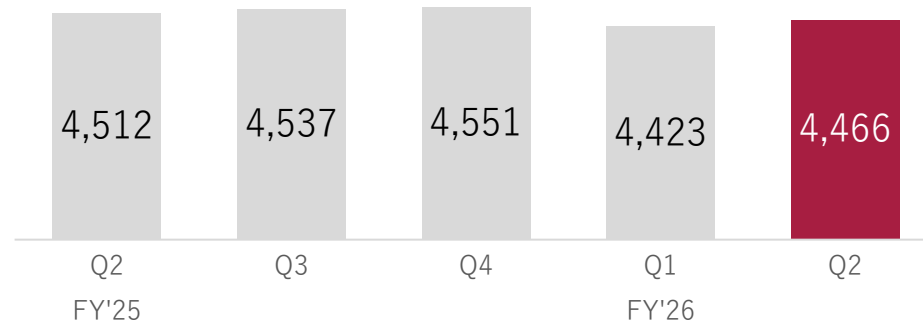
	Q1 (第1四半期)	Q2 (第2四半期)	Q3 (第3四半期)	Q4 (第4四半期)	通 期
連結・当社・国内子会社	3月～5月	6月～8月	9月～11月	12月～翌年2月	3月～翌年2月
海外子会社	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～12月

会社概要

RORZE

会社名	ローツェ株式会社（英文名；RORZE CORPORATION）
上場市場	東京証券取引所 プライム市場（証券コード：6323）
所在地	広島県福山市神辺町
設立	1985年3月30日
資本金	982百万円
事業内容	半導体・フラットパネルディスプレイ（FPD）・ライフサイエンス関連の自動化・搬送装置の開発・製造・販売
従業員数 ※	連結：4,466名 当社：379名（2026年8月末現在）
事業拠点	国内：福山・横浜・熊本・つくば・東京 海外：米国・ベトナム・台湾・韓国・シンガポール・中国・ドイツ・フランス

従業員数の推移（連結）※



※ 従業員数は、臨時従業員および再雇用従業員の年間平均雇用人員を含めた人数

グローバルネットワーク



- 開発・生産・営業・サポート
- 営業・サポート
- 開発・生産
- サポート



2027年2月期（第42期）
第2四半期（2026年3月～8月）
連結業績

業績ハイライト

RORZE

第2四半期（2026年3月～8月）連結

売上高

79,733 百万円

前年同期比 **+21.5%**

営業利益

23,096 百万円

営業利益率 **29.0%**

前年同期比 **+42.4%**

経常利益

24,538 百万円

経常利益率 **30.8%**

前年同期比 **+68.4%**

親会社株主に帰属する

四半期純利益

15,839 百万円

純利益率 **19.9%**

前年同期比 **+45.7%**

過去最高の増収増益

- 半導体関連装置の売上高は671億円で過去最高を更新
- 売上高・各利益とも前年同期を大きく上回る

増収と円安により増益

- 売上増加により、営業利益は前年同期比で大幅増益
- 前年同期より円安となり、為替損益の改善も寄与したことから、経常利益は大幅増益

受注も過去最高を更新

- 半導体関連装置のQ2受注高785億円で前年同期比3.2倍
- 半導体関連装置の受注残高1,038億円で前年同期比2.3倍

連結業績



- 生成AIの需要拡大などによる半導体設備投資の増加を背景に、好調な事業環境が継続
- 売上高は主力の半導体関連装置が牽引し過去最高を更新、大幅な増収増益
- 分析装置は、顧客の装置検収時期のずれ込みや部品調達・生産リードタイムの長期化により減収
- 増収および円安により、営業利益、経常利益、四半期純利益はいずれも大幅な増益

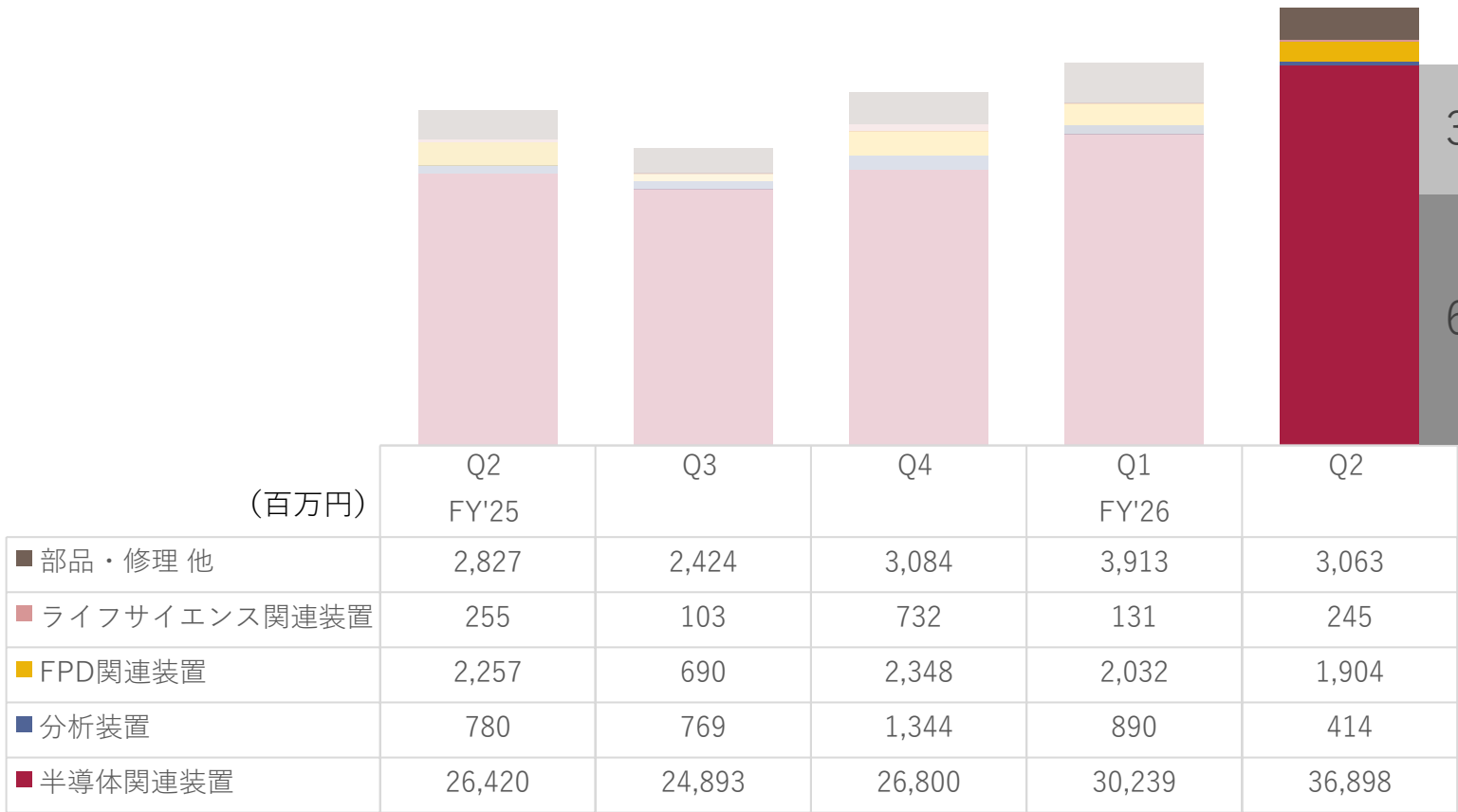
(百万円)

	FY'26 Q2	FY'25 Q2	前年同期比
売上高	79,733	65,602	121.5%
半導体関連装置	67,138	54,650	122.8%
分析装置	1,304	1,440	90.6%
F P D 関連装置	3,936	3,259	120.8%
ライフサイエンス関連装置	376	366	102.8%
部品・修理 他	6,977	5,886	118.5%
営業利益	23,096	16,214	142.4%
経常利益	24,538	14,572	168.4%
親会社株主に帰属する四半期純利益	15,839	10,872	145.7%
期中平均レート (円/USD)	158	149	—

四半期売上高の推移



- 四半期売上高は前四半期比14%増、2四半期連続で過去最高を更新
- 半導体関連装置は前四半期比22%増、全体の増収を牽引



N2パージウエハストッカ

ウエハソータ

エンドユーザー

装置メーカー

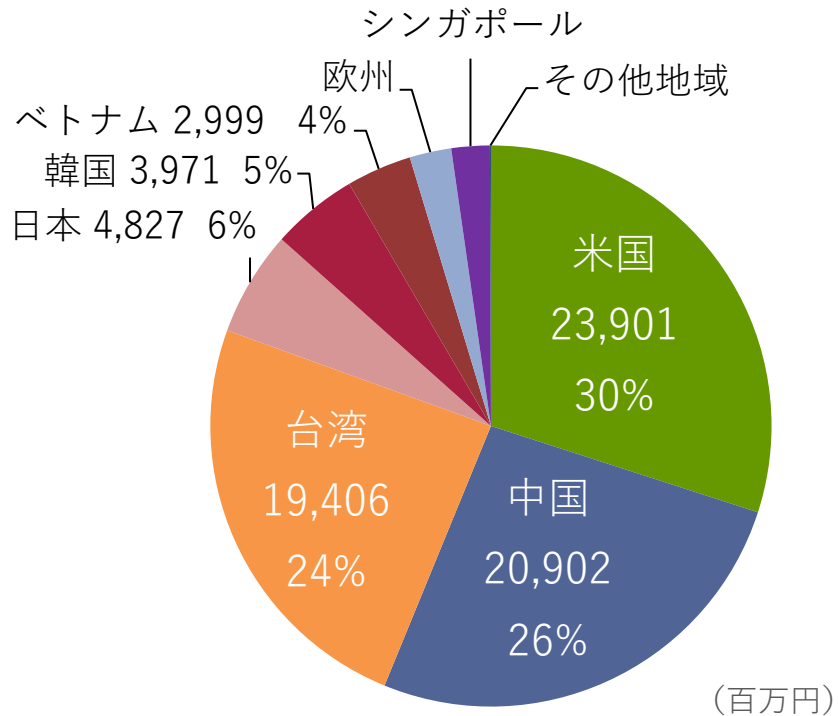
EFEM

真空プラットフォーム

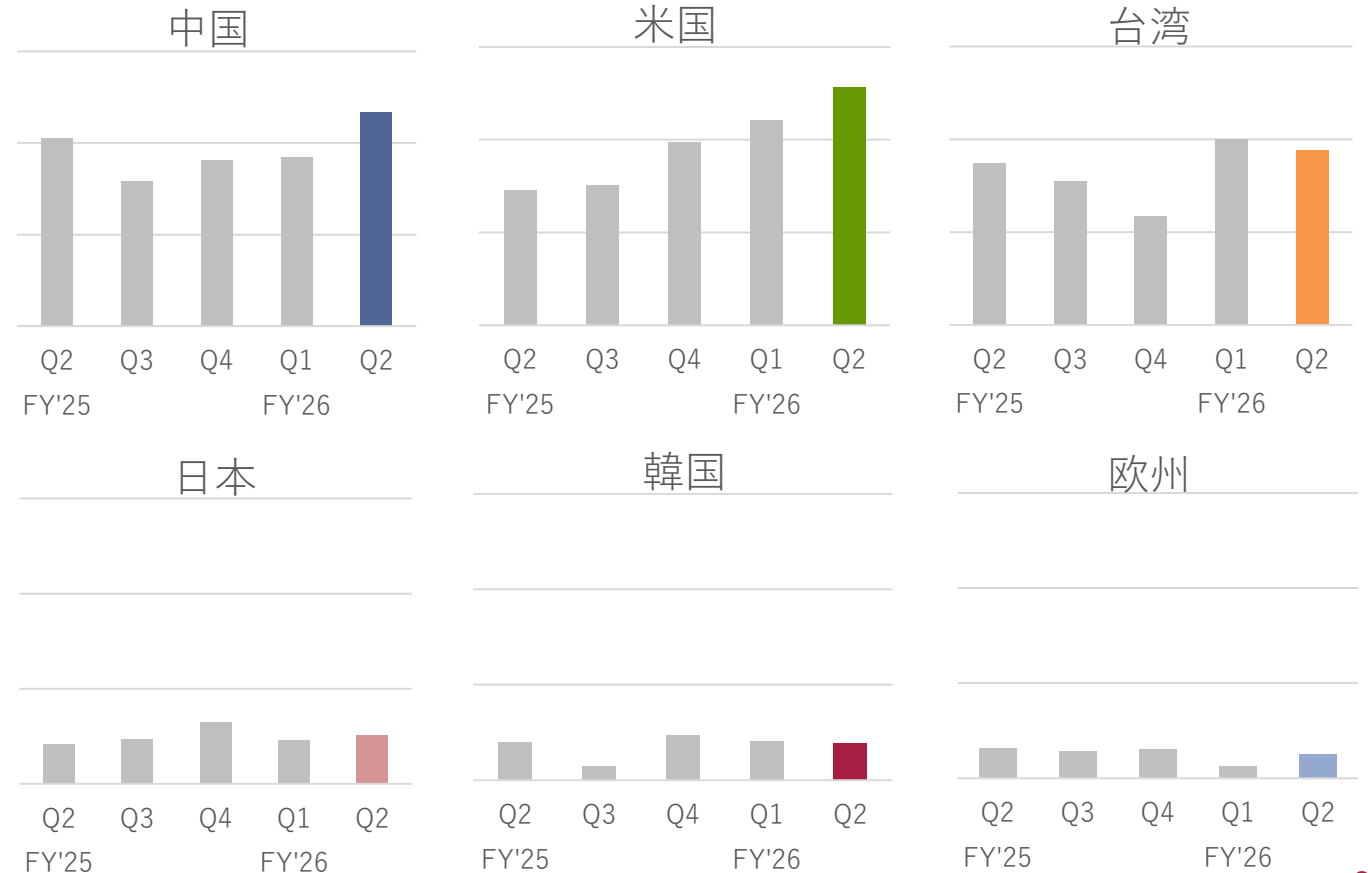
地域別売上高



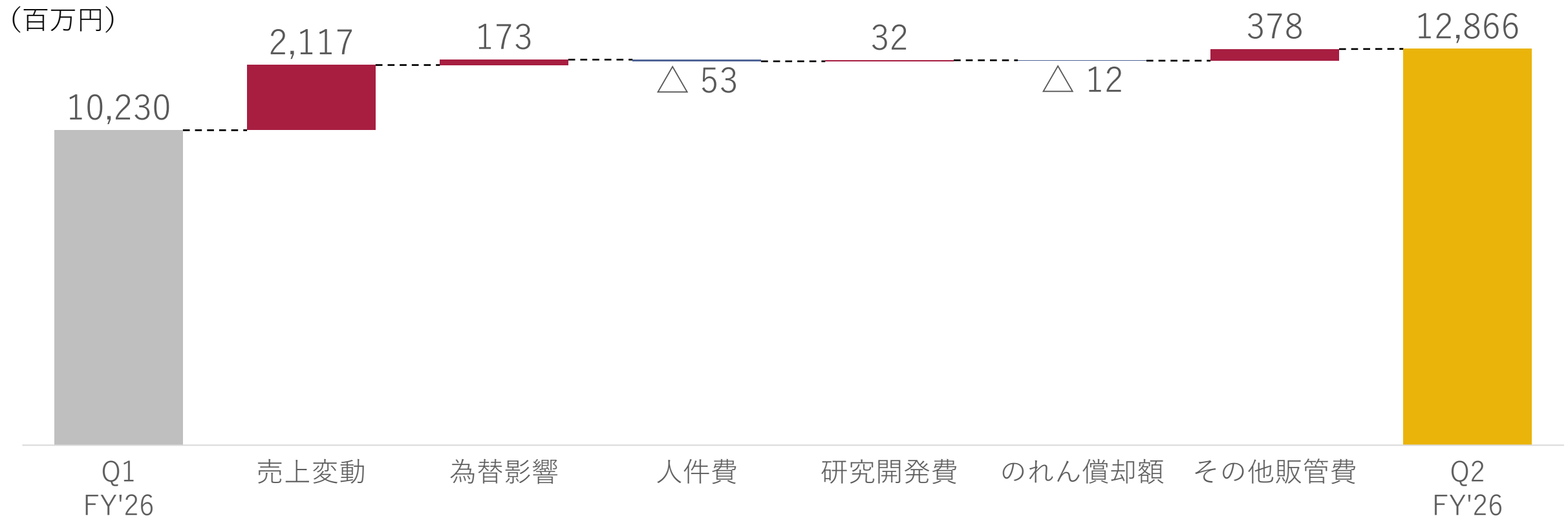
- 四半期売上高は上位3地域で全体の8割を占め、米国が過去最高を更新
- 米国は装置メーカーおよびメモリメーカー向けが伸長、4四半期連続で増加
- 中国は装置メーカー向けが3四半期連続で増加
- 台湾は前四半期比で減少も高水準を維持、ファウンドリおよびメモリメーカー向けが好調



※ 「地域別売上高」は顧客企業の本社所在地別に集計



- 半導体関連装置の増収と販管費の減少により、営業利益は前四半期比26%増の128億円



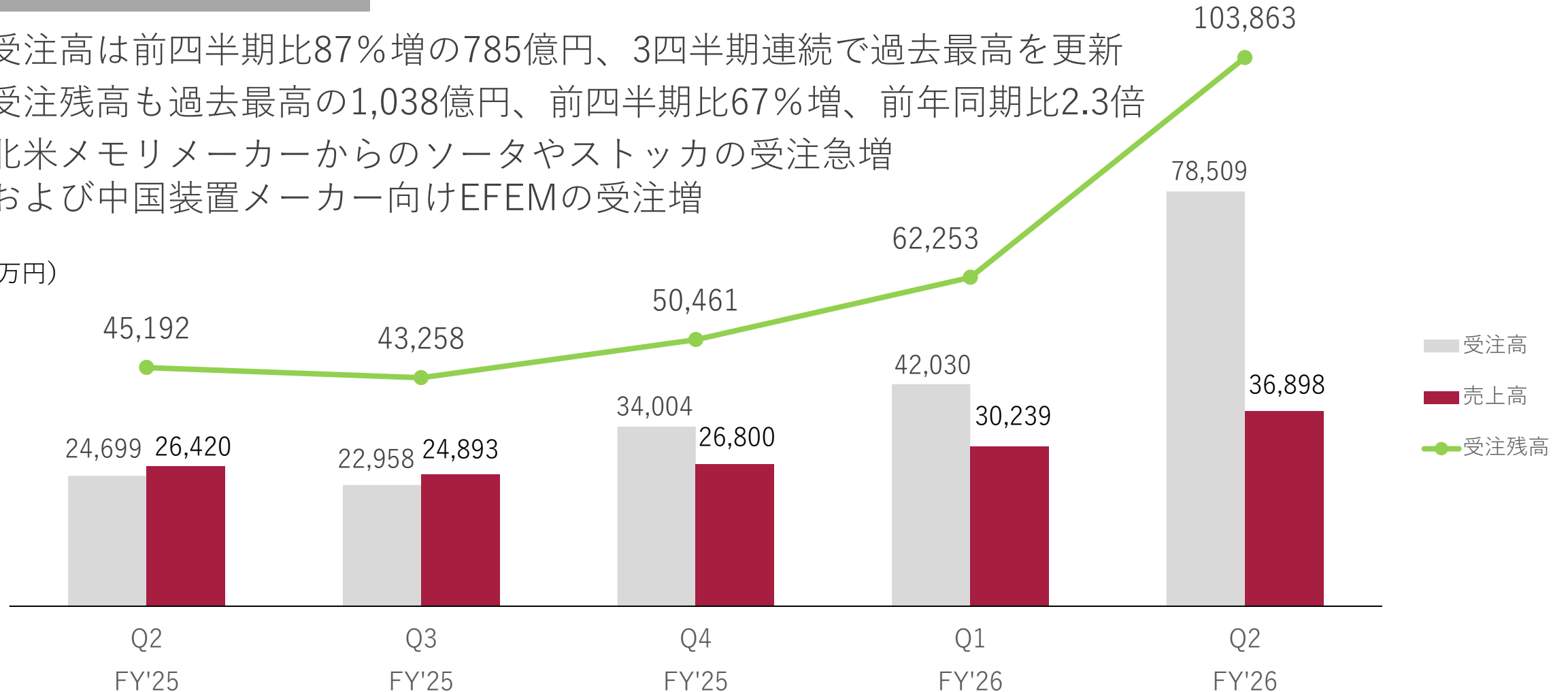
※ 連結営業利益に対するNanoverse社のQ2累計影響額(百万円)： 人件費1,011、研究開発費22、のれん償却額1,489、その他販管費614

受注高・売上高・受注残高の推移

半導体関連装置

- 受注高は前四半期比87%増の785億円、3四半期連続で過去最高を更新
- 受注残高も過去最高の1,038億円、前四半期比67%増、前年同期比2.3倍
- 北米メモリメーカーからのソータやストッカの受注急増
および中国装置メーカー向けEFEMの受注増

(百万円)

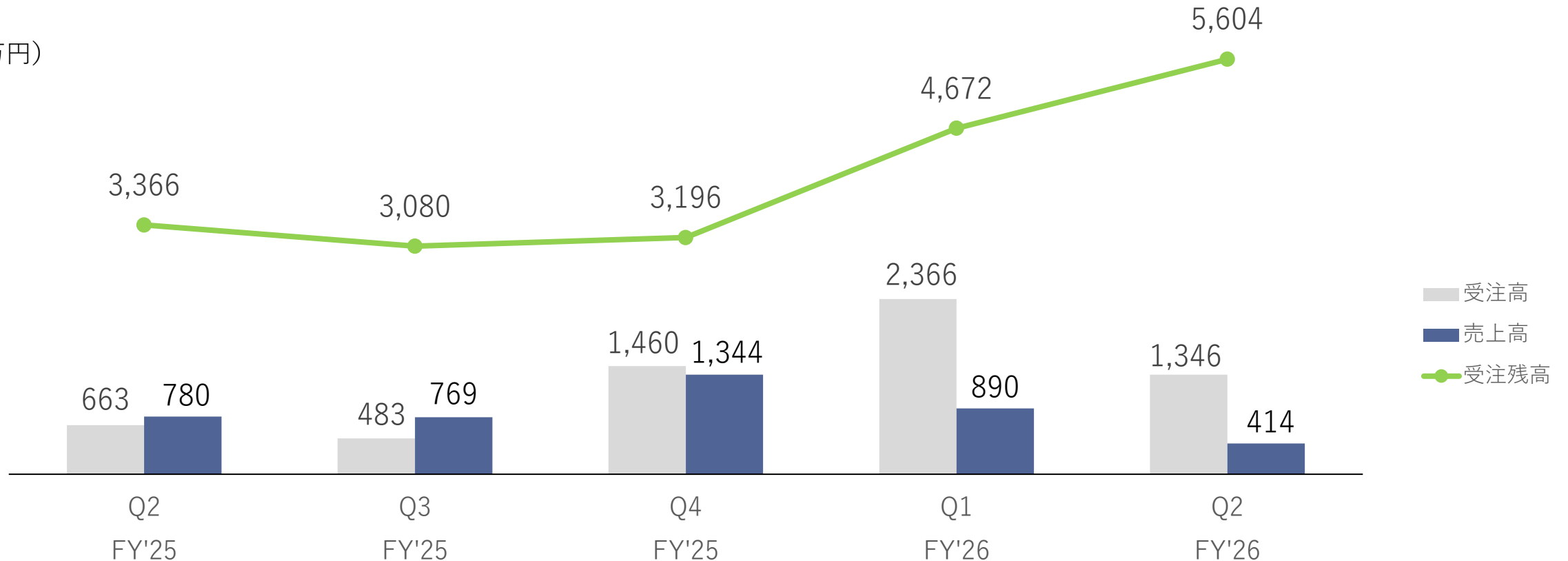


受注高・売上高・受注残高の推移

分析装置

- 受注高は前四半期比10億円減の13億円、受注残高は56億円に増加
- 受注は堅調なるも顧客の検収時期のずれ込みや部品調達・生産リードタイムの長期化により減収

(百万円)



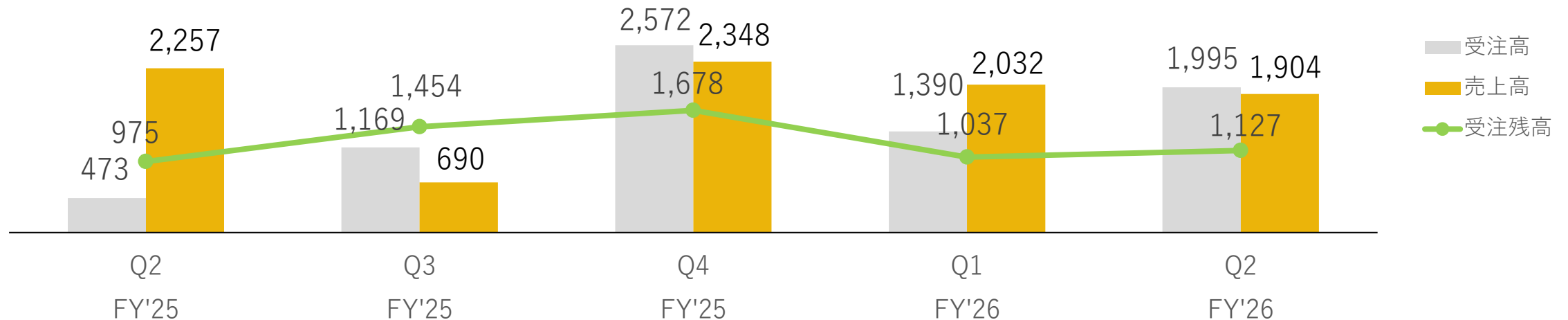
受注高・売上高・受注残高の推移



FPD関連装置

- 受注高は前四半期比44%増の19億円、売上高は同6%減の19億円
- 受注高は若干増加したものの受注残高は前四半期比9%増の11億円で横ばい

(百万円)



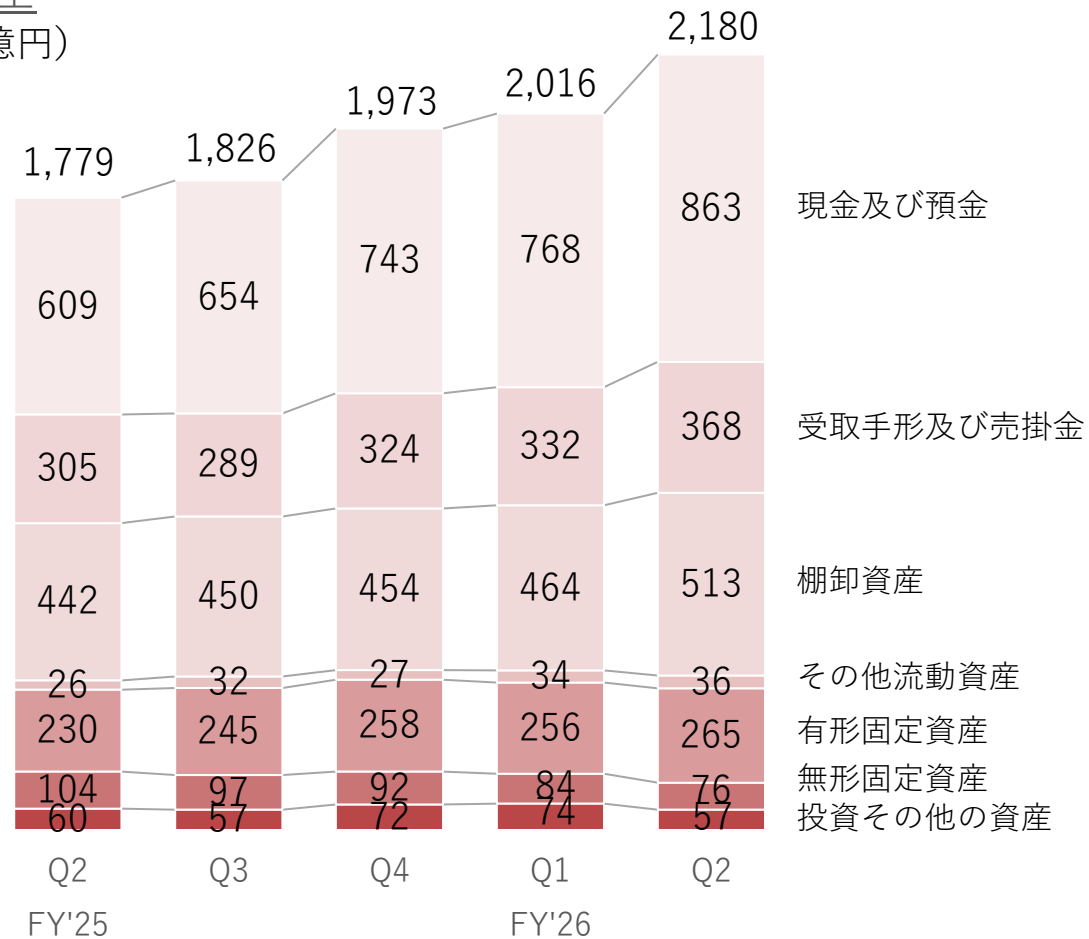
連結貸借対照表



■ 受注増に伴う原材料・仕掛品の増加により棚卸資産は前期末比59億円増加

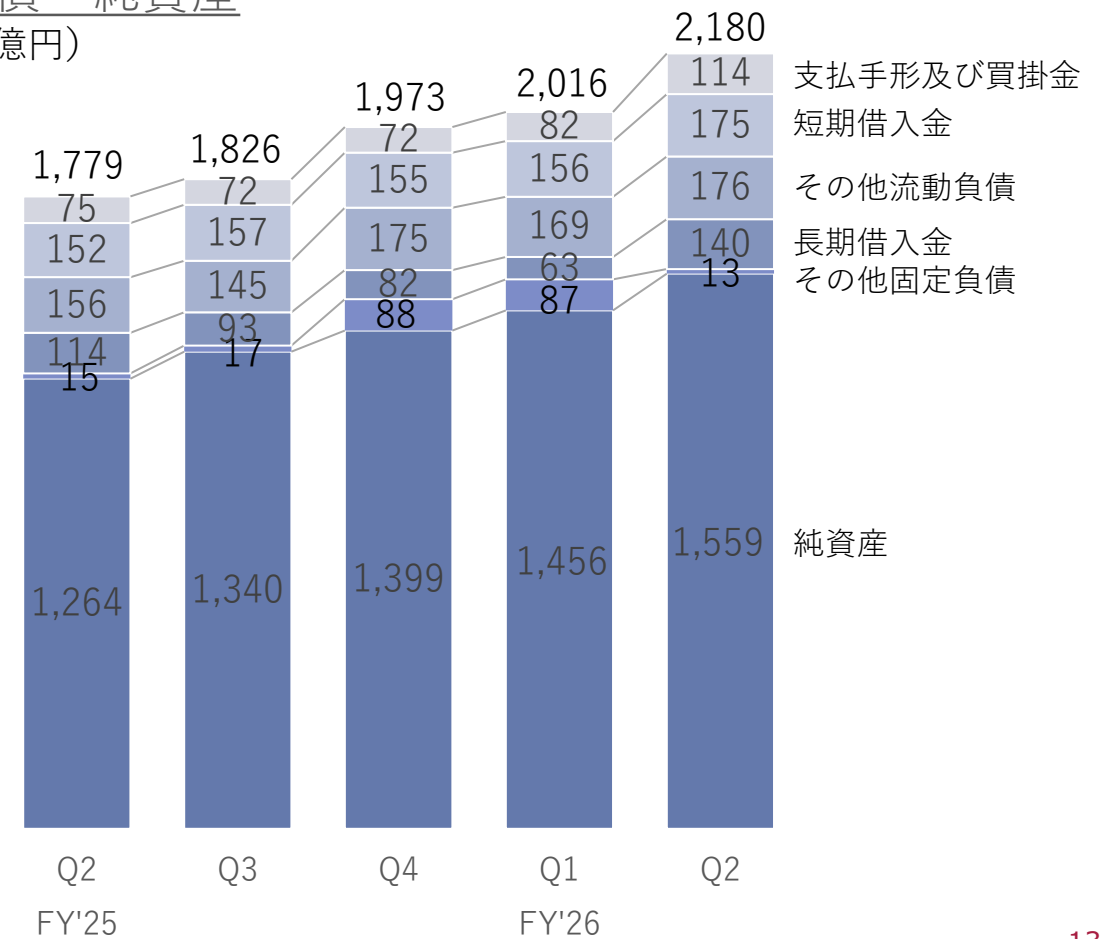
資産

(億円)



負債・純資産

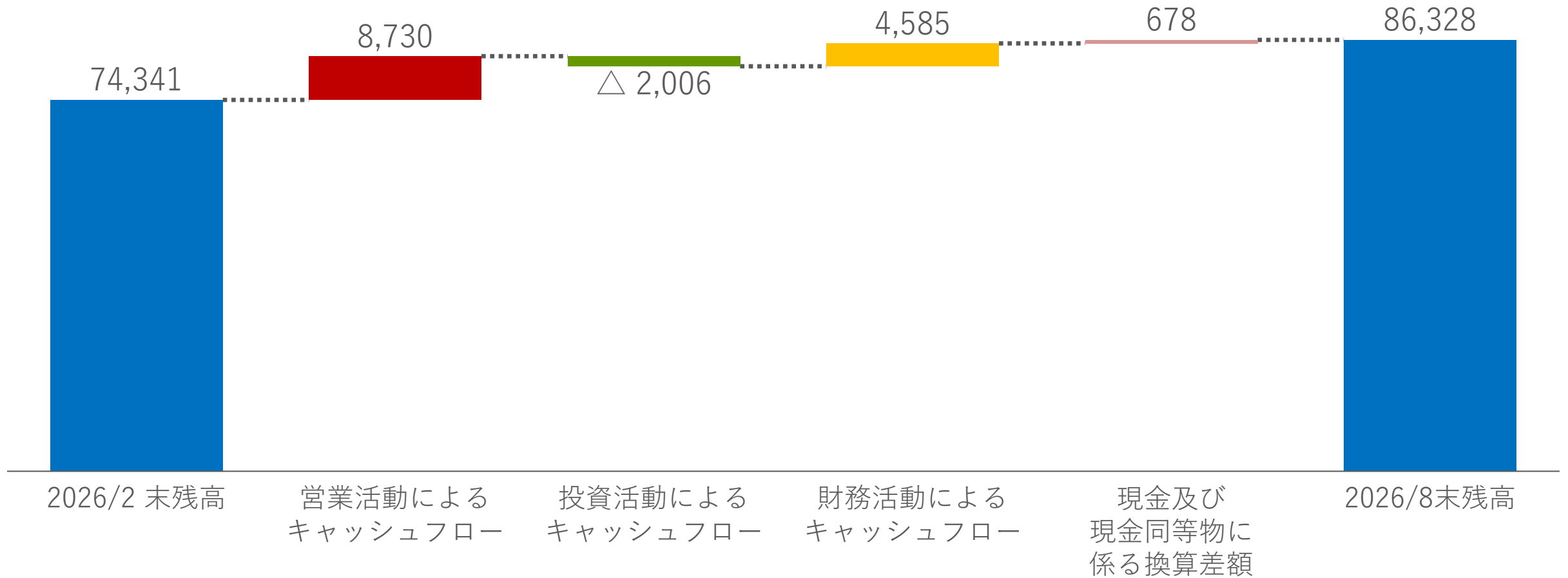
(億円)



2027年2月期第2四半期 キャッシュ・フロー



(百万円)



■ 特許訴訟の和解成立について

- 米国時間2022年8月30日に、当社および当社の米国子会社のRorze Automation, Inc.の製品が川崎重工業株式会社の米国特許権を侵害するものとして訴訟を提起されておりました
- その後、2026年3月13日付で陪審評決が下されておりましたが、当事者間で和解協議を進めた結果、2026年8月3日付で和解契約を締結いたしました
- 和解の内容につきましては、和解契約に定める秘密保持義務に基づき公開を差し控えさせていただきます
なお、本件和解により当該訴訟は終局的に解決されることとなり、今後の事業活動への影響はありません

■ 連結子会社Nanoverse社の進捗状況

- Nanoverse社から顧客に納入した評価装置に対する評価継続中
- 顧客から出ている課題についてのアプローチを継続している状況
- 早期に顧客の評価が完了し、今期中の売上計上が可能となるよう交渉中



2027年2月期（第42期） 今後の見通し

事業環境・需要の見通し

- 生成AIの普及、活用拡大などにより、高性能で高効率な半導体チップへの需要が拡大、半導体製造装置への投資拡大が加速
- HBM需要を背景に先進メモリや先端ロジック投資が増加、デバイスメーカーによる新規設備投資や生産能力増強が拡大
- 引き続き先端半導体やアドバンスドパッケージ向け搬送装置の受注増加傾向が続く見通し

調達面のリスク

- メモリ価格の高止まりや調達部品の長納期化により、調達コストの上昇や必要部材の確保が遅れるリスク
- 各社調達において部材確保のための先行手配競争が過熱化し始めている

供給体制・調達の対応

- 半導体関連装置の受注急増に対し、ベトナム、中国の子会社での増員、生産エリアの確保による製品供給体制を増強
- 部材の先行手配・在庫確保、代替部品・代替調達先の確保により、納期への影響を緩和

2027年2月期 通期連結業績予想の修正



- 半導体関連装置の受注急増により、通期売上高は209億円増の1,800億円へ上方修正
- 営業利益は期初予想比39%増の530億円へ上方修正
- 当社グループにおける生産供給体制の増強をはかる

(百万円)

	修正後 通期予想(A)	期初 通期予想(B)	増減額 (A - B)	増減率 (A ÷ B)	Q2実績 (C)	修正後 下期予想(A - C)	修正後進捗率 (C ÷ A)
売上高	180,007	159,021	20,985	113.2%	79,733	100,273	44.3%
半導体関連装置	152,970	132,480	20,490	115.5%	67,138	85,832	43.9%
分析装置	3,490	4,225	△735	82.6%	1,304	2,185	37.4%
FPD関連装置	7,349	10,090	△2,740	72.8%	3,936	3,412	53.6%
ライフサイエンス関連装置	1,616	1,588	28	101.8%	376	1,240	23.3%
部品修理他	14,579	10,636	3,942	137.1%	6,977	7,601	47.9%
営業利益	53,078	38,112	14,965	139.3%	23,096	29,981	43.5%
経常利益	54,889	38,241	16,647	143.5%	24,538	30,350	44.7%
親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益	37,779	27,809	9,970	135.9%	15,839	21,939	41.9%
期中平均レート（円／USD）	158	159	—	—	158	—	—

生産能力の拡大施策

ベトナム

■ 人員の確保と定着

- ベトナム工場での従業員採用を加速
- 8月に賃上げを実施

■ 生産面積の拡充

- 既存工場の倉庫機能を外部レンタル工場へ移設
- 空きスペースをクリーンルーム化、組立フロア面積を拡大

■ 新工場の稼働前倒し

- 2028年Q1稼働予定 → 2027年Q4の稼働開始へ

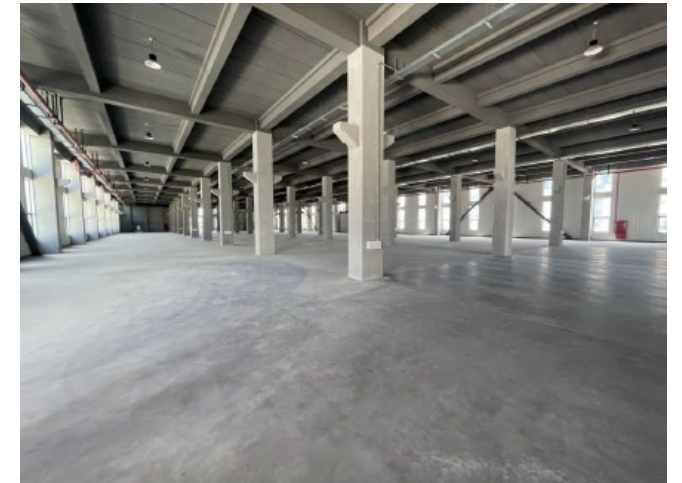


中国 上海臨港 新工場

中国（上海臨港）

■ 生産増強

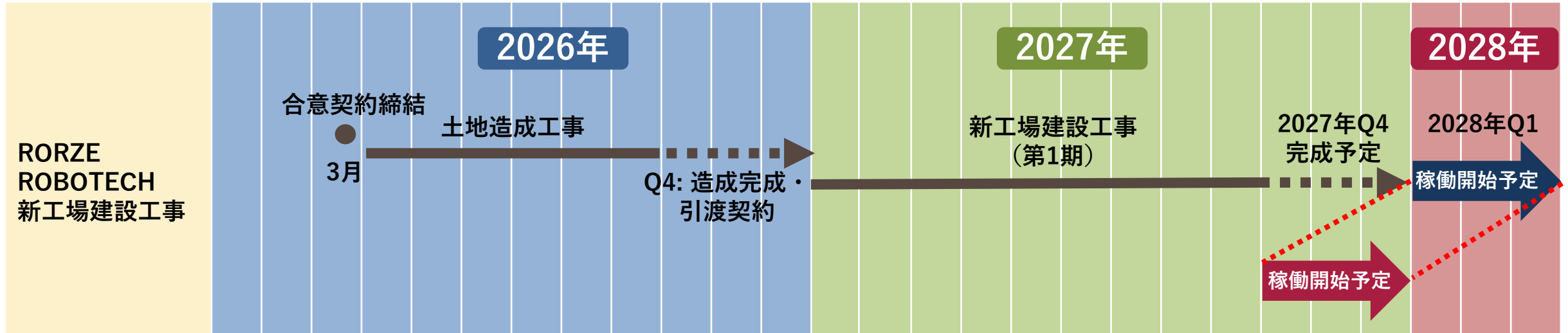
- 既存工場を2シフト勤務体制へ移行
- 近隣に新建屋を賃借、工場を拡張（2027年春より稼働開始予定）



ベトナム新工場

RORZE

- 新工場稼働開始時期の前倒し 2028年Q1稼働予定 → 2027年Q4稼働開始へ
- 将来的な事業環境や設備投資ニーズに応じて生産能力拡大をはかる



完成イメージ図（今後変更の可能性あり）

床面積に基づく生産能力試算

エリア	既存工場	新工場	面積比 ※
組立	14,400m ²	60,000m ²	5.2倍
部品製造	18,150m ²	53,200m ²	3.9倍

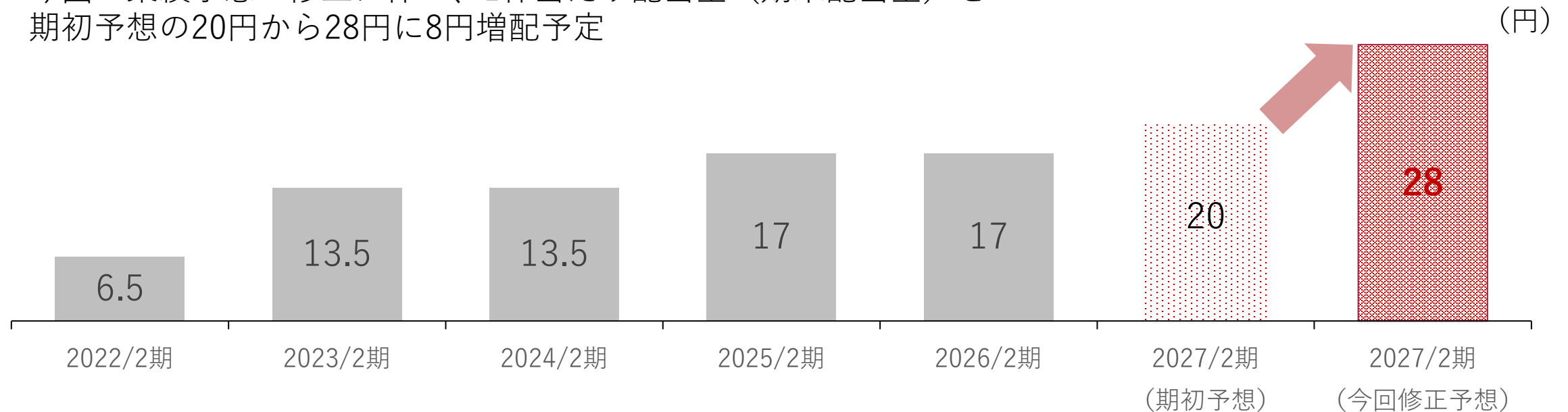
※ 面積比は、すべての新工場完成後の床面積合計を既存工場床面積で除した倍率

■ 株主還元について

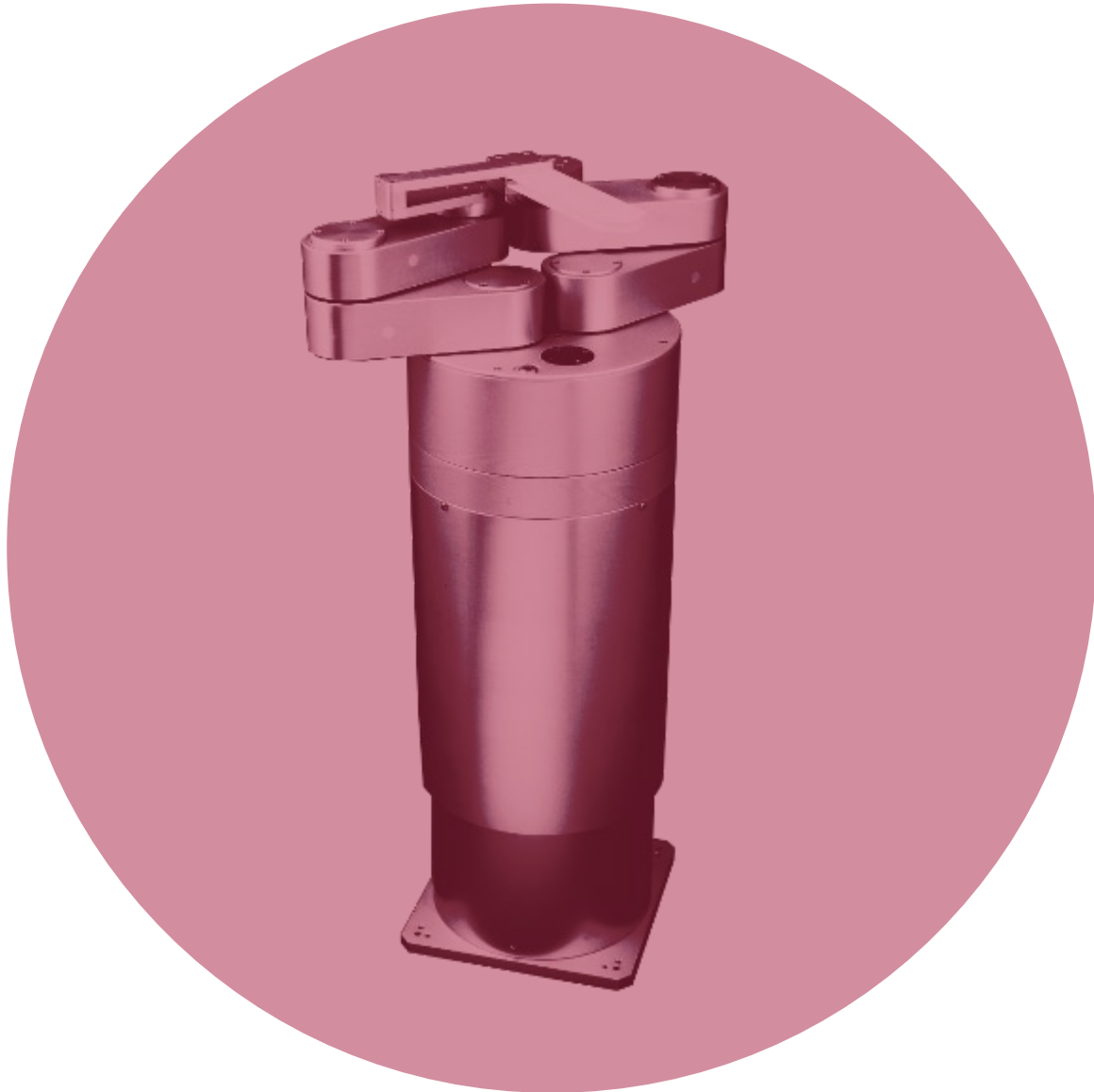
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題のひとつと認識し、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の維持を基本とし、業績の推移及び財務状況等を総合的に勘案して利益還元を行う方針であります。

■ 1株当たり配当金（期末配当金）

今回の業績予想の修正に伴い、1株当たり配当金（期末配当金）を
期初予想の20円から28円に8円増配予定



※ 2024年9月1日を効力発生日として普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施しています。
そのため1株当たり配当金は当該株式分割の影響を考慮した金額を記載しています。



参考資料

ユニット



大気用搬送ロボット



アライナ



ロードポート

システム



EFEM



真空プラットフォーム

システム



ウエハソータ



N2パージウエハストック

装置メーカー

プロセス装置

検査装置

エンドユーザー

デバイスメーカー

ウエハメーカー

アドバンスドパッケージ

より小さいフットプリントで高いデバイス密度と機能拡張を実現できるようにチップレットを接続する方法

■PCB(プリント基板)上でのパッケージング

前工程 1 ウェハで1種類のチップ

これまでのローツェ搬送装置の市場

中工程 後工程のパッケージングをする代わりに、
・ウェハを薄くしてシリコンを貫通する通信用の縦穴形成 (TSV: Through Silicon Via)
・インターポーザ (※) 上で**複数のウェハを3Dに積層する**

ローツェの搬送装置が必要な新市場が拡大 (前工程 + 中工程)

後工程 1 パッケージで1種類のチップ

PCB基板上にマウンターでパッケージング
(各半導体間はPCB基板を通じて通信)

■シリコンウェハ上でのパッケージング

● アドバンスドパッケージ用装置

- ・ Tape Frame Sorter
- ・ PLP EFEM など

※インターポーザ： 貫通電極によって表裏の回路の導通をとり中継する基板
(シリコンインターポーザ、ガラスインターポーザ、有機インターポーザ)

アドバンスドパッケージ用装置

RORZE



PLP用EFEM



Tape Frame用ソーター





半導体業界

製造装置メーカー

エンドユーザー

デバイスメーカー

ウエハメーカー

半導体業界以外

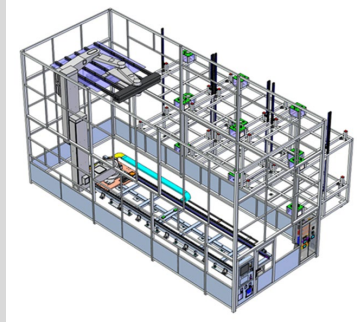
研究機関

環境計測機器

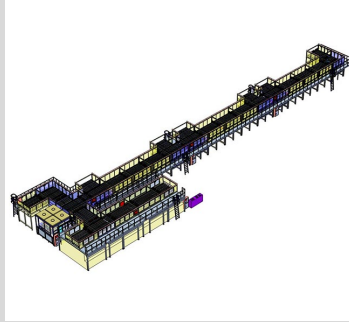
化学薬品メーカー

など

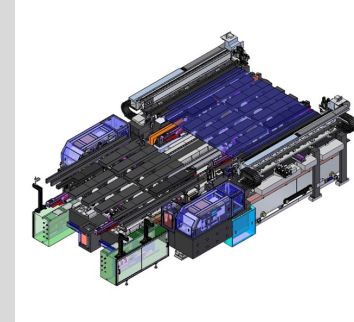
RORZE
ローツェシステムズ
(韓国子会社)



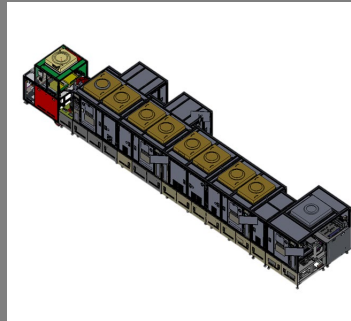
INDEX超大型搬送システム



インライン搬送システム



レーザーカッティング装置



ディスプレイモジュール機器



Packing 超大型Cell装置

前工程：

FPDメーカー
FPD用ガラスメーカー

後工程：

FPDメーカー

ライフサイエンス関連装置

RORZE

RORZE
Lifescience



インキュベータ
SCALE48



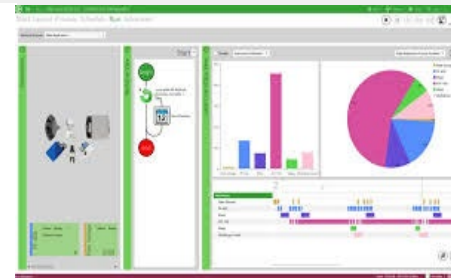
自動培地交換機能&細胞観察
機能付きCO2インキュベータ
CellKeeper® II 48Plus



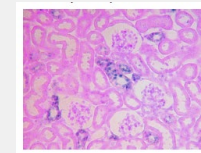
モバイルロボット



全自動培地交換システム
CellFarm(L)-360™



スケジューリングソフトウェア
Green Button Go™ ※
(※Biozero社製)



試験受託(細胞染色)

GenoStaff
ジェノスタッフ株式会社

大学・製薬企業等
研究機関
再生医療関連企業

RORZE